

**HA8000シリーズ
ハードウェア アーキテクチャーガイド
(2014年6月～モデル)**

本アーキテクチャーガイドの注意事項について

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写することは固くお断りします。
- 本書の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、ご連絡頂けますようお願いいたします。
- 本書の内容については ハードウェアの基本ブロック図の記載のみです。

登録商標・著作権

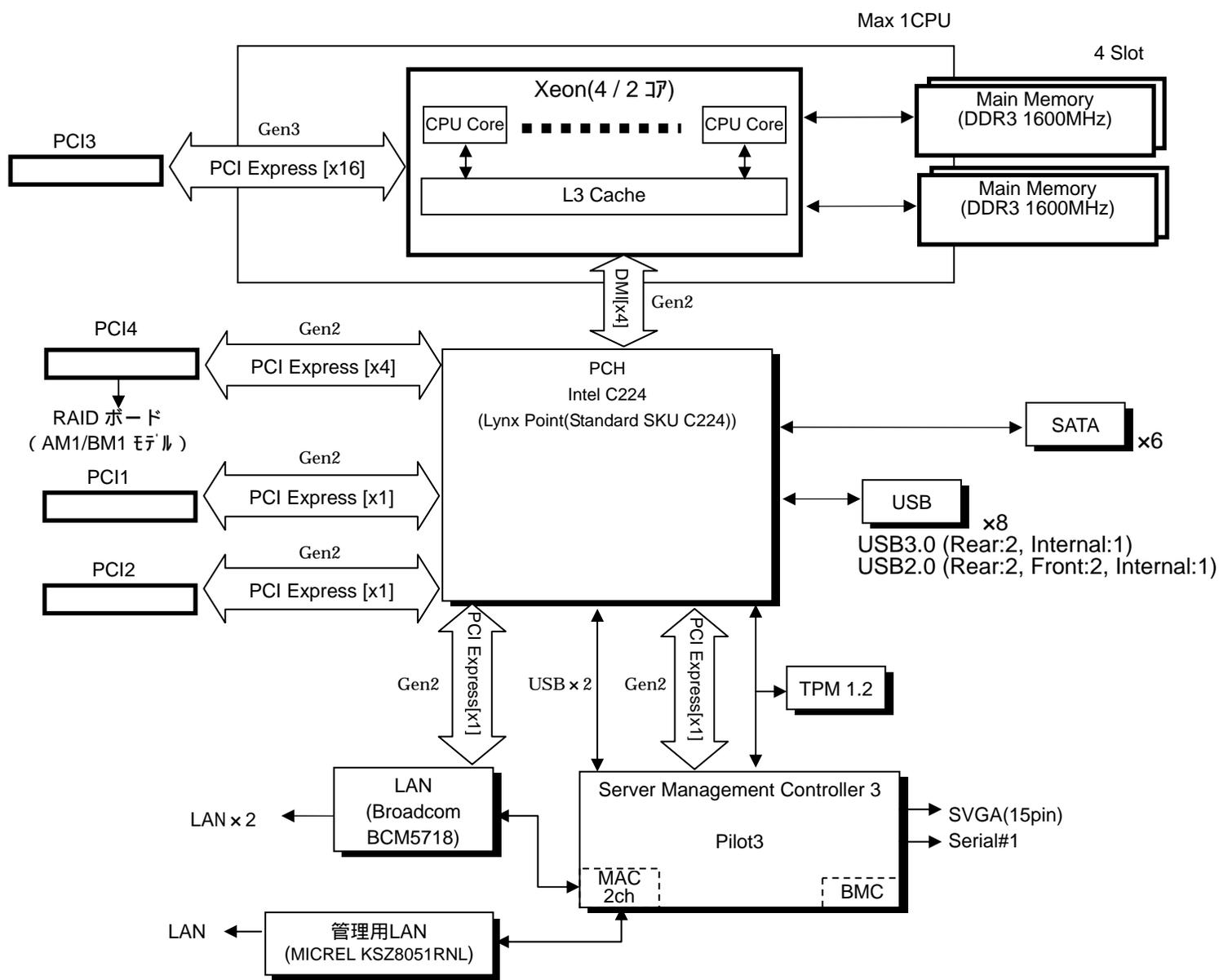
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
その他、本マニュアルに記載されている製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

**(株)日立製作所 ITプラットフォーム事業本部
事業統括本部 PF ビジネス本部
サーバビジネス推進部
2014年6月作成(第1版)**

HA8000/TS10 アーキテクチャー

HA8000/TS10 AM1, BM1, CM1, EM1 には以下の特徴があります。

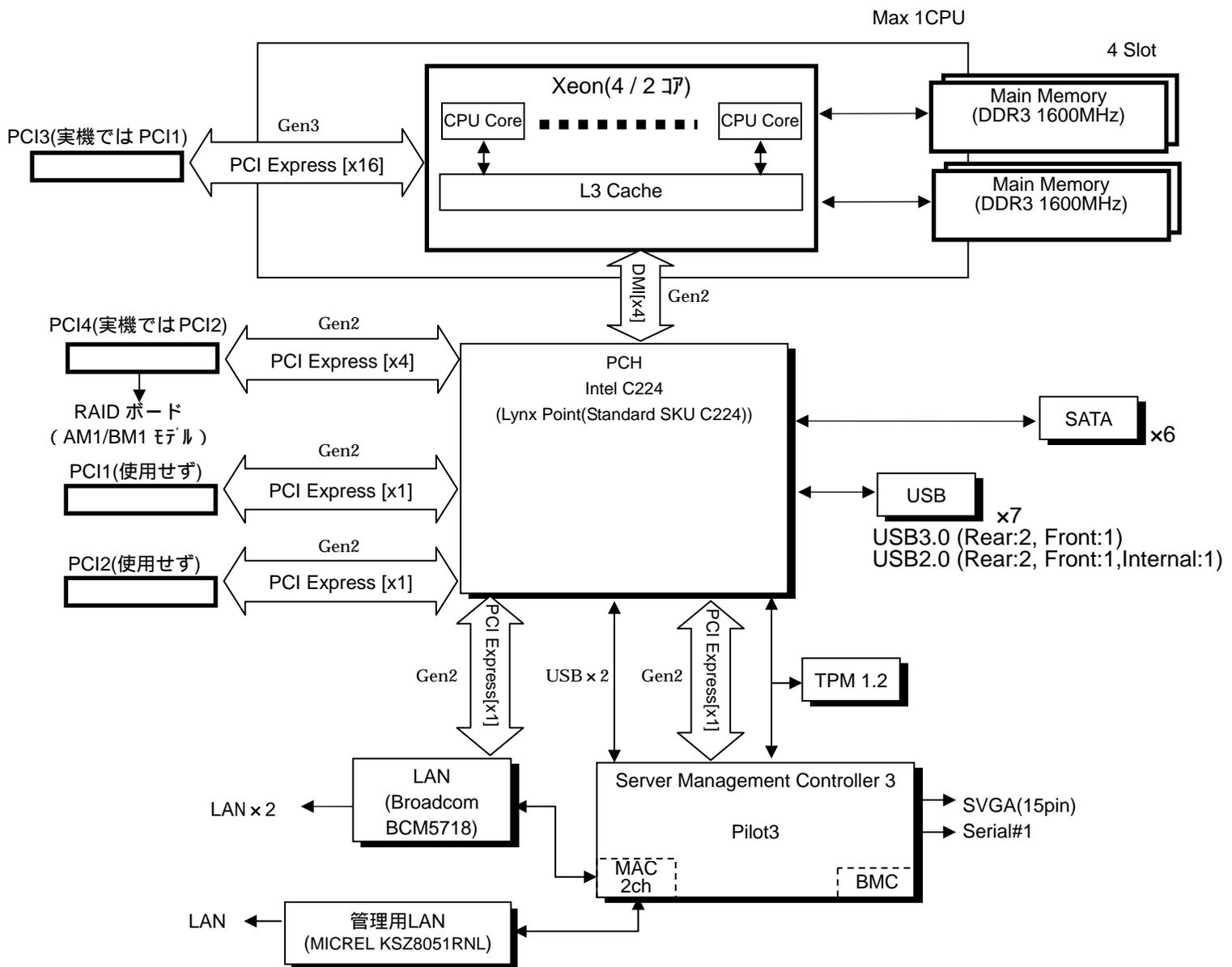
- ・インテル社製 C224 チップセット採用による 1 プロセッサシステムの実現
- ・インテル Xeon プロセッサ E3-1281v3(3.70GHz)^{*1}、E3-1280v3(3.60GHz)^{*2}、E3-1271v3(3.60GHz)^{*1}、E3-1270v3(3.50GHz)^{*2}、E3-1220v3(3.10GHz)/インテル Pentium プロセッサ G3430(3.30GHz)の採用
*1: TS10AM1, BM1, CM1 用
*2: TS10EM1 用
- ・DDR3 1600 Unbuffered ECC DIMM 採用による高速 I/O の実現
- ・メインメモリーを最大 32GB 搭載可能。
- ・PCI Express 3.0 (16 レーン) の採用



HA8000/RS110 アーキテクチャー

HA8000/RS110 AM1, BM1, CM1, EM1 には以下の特徴があります。

- ・インテル社製 C224 チップセット採用による 1 プロセッサシステムの実現
- ・インテル Xeon プロセッサ E3-1281v3(3.70GHz)^{*1}、E3-1280v3(3.60GHz)^{*2}、E3-1271v3(3.60GHz)^{*1}、E3-1270v3(3.50GHz)^{*2}、E3-1220v3(3.10GHz)/インテル Pentium プロセッサ G3430(3.30GHz)の採用
- *1: RS110AM1, BM1, CM1 用
- *2: RS110EM1 用
- ・DDR3 1600 Unbuffered ECC DIMM 採用による高速 I/O の実現
- ・メインメモリーを最大 32GB 搭載可能。
- ・PCI Express 3.0 (16 レーン) の採用



HA8000/RS440 アーキテクチャー

HA8000/RS440 AM には以下の特徴があります。

- ・インテル社製 C602J チップセット採用による 4 プロセッサシステムの実現
- ・インテル Xeon プロセッサ E7-4890v2(2.80GHz)/E7-4860v2(2.60GHz)/E7-4809v2(1.90GHz)の採用。
- ・DDR3 1600 RDIMM および、DDR3 1600 LRDIMM の採用により高速な I/O を実現。x4/x8 SDDC、Lockstep、メモリラーリング、Rank Sparring Mode、Demand and Patrol Scrubbing 対応。最大 2TB 搭載可能。

